

SnBi系 異方導電接続 コネクタ接続代替

Replace of mechanical connectors, SnBi-solder type Joint method /connector /ACF,ACP



SAM32

特長
Feature

・低温短時間(低圧)硬化

Low temprature, short time, and low pressure curing

・省スペース軽量設計に最適

For space saving and lightweight design

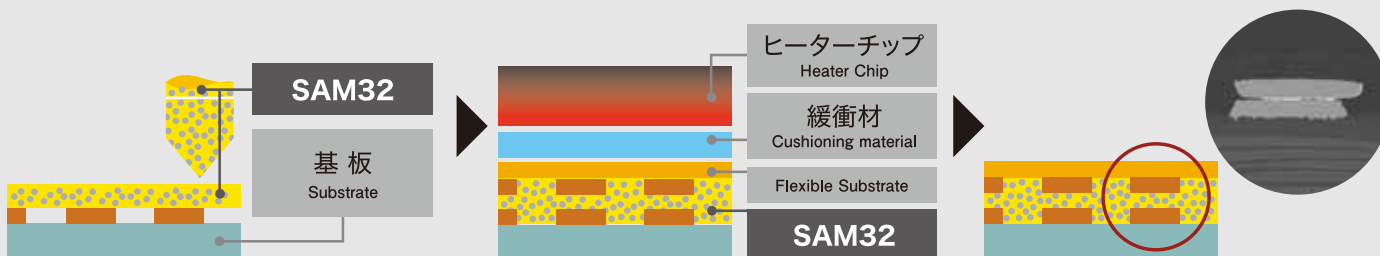
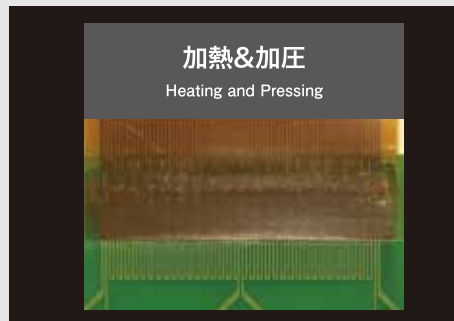
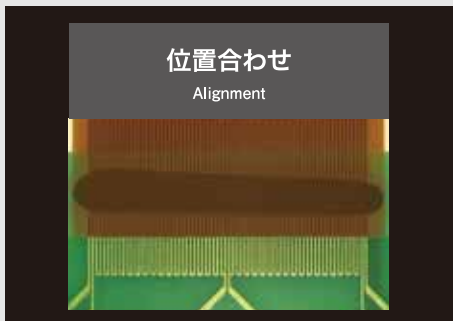
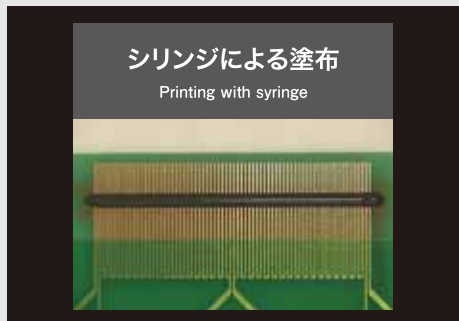
・リワーク可能

Reworkable

・ハロゲンフリー / VOCフリー

Halogen-free / VOC-free

工程
Process

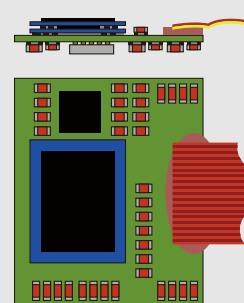
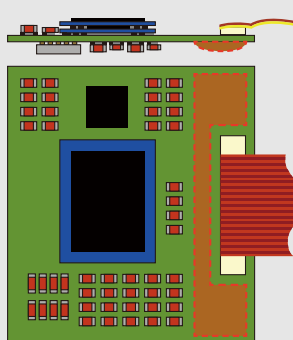
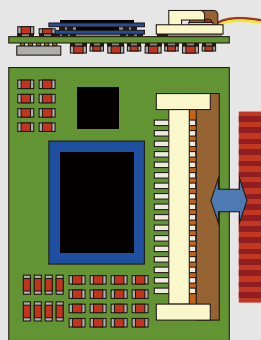


接合方式 Joint method

コネクタ connector

接触接続(ACFなど) ACF, ACP

M/M-ESC SAM32



省スペース軽量設計に最適
For space saving and lightweight design

項目 Item

SAM32-401E-13

柔軟性樹脂タイプ Flexible resin type

性状 Component type	ペースト Paste
はんだ合金組成 Solder Alloy composition	融点 Melting point
塗布方法 Coating method	ディスペンス、ジェットディスペンス Dispense, JET dispense
標準圧着条件 Standard bonding conditions	150°C, 6sec, 1MPa
0.2mmPitch (L/S=100/100μm) 対応 Correspond	可能 Possible
硬化樹脂弾性率 Young modulus	<0.1GPa
ポットライフ Pot life	≤30°C ≤24h
リワーク Rework	可能(150°C) Possible150°C
適用可能 L/S Available L/S	100/100

